

Press Information

2023年2月22日

第192回電子セラミック・プロセス研究会に登壇します

日機装株式会社は、電子セラミック・プロセス研究会が主催する「第192回 電子セラミック・プロセス研究会」に、インダストリアル事業本部 精密機器技術センターの牧野 由が登壇します。

3月4日（土）に開催される第192回は「パワー半導体 SiC・GaN の現状と未来、最新プロセス」を特集テーマとしており、16:00~17:10 に行われる講演にて、当社の牧野が当社独自の特殊ゲル状加圧媒体を用いた立体的な3Dプレス方法での均一圧着により、効率的かつ高品質なモジュール製造が可能となる技術を説明、またパワー半導体の接合特性に合ったシンタリング（焼結）装置「3D シンター」の開発内容についてご紹介いたします。

皆様のご参加をお待ちしております。

開催概要

研究会名	第192回電子セラミック・プロセス研究会 http://elecerapm.com/program/192/program192.php
日時	2023年3月4日（土）13:00 ~ 17:20
場所	TKP 品川カンファレンスセンター-ANNEX + Zoom オンライン ハイブリッド開催 〒108-0074 東京都港区高輪3丁目13-1 TAKANAWA COURT 3F (JR 山手線 品川駅 高輪口 徒歩4分)
プログラム	<ol style="list-style-type: none"> ① 「SiC アライアンスの活動と2100年のモビリティ」 (13:00~13:40) 戸田敬二 (SiC アライアンス副会長・推進委員長) ② 「SiC MOSFET の最新技術」 (13:45~14:25) 岩室憲幸 (筑波大学 数理物質系) ③ 「ScAlMgO4 結晶の GaN 成長用基板としての可能性と今後の展開」 (14:30~15:10) 小島孝広 (株式会社オキサイド 新事業推進室(兼)営業本部 マネージャー) ④ 「パワー半導体のサイクル試験とストレス印可での製品故障と解析」 (15:20~16:00) 佐藤 英登 (株式会社デンケン イノベーションセンター フェロー) ⑤ 「Pressure sintering - overview and market trends 」 (16:00-16:40) Mr. Florian Seifert (Heraeus Electronics Global Product Manager Power Modules) ⑥ 「パワー半導体向け3Dプレス技術とシンタリング(焼結)装置開発」 (16:40~17:10) 牧野 由(日機装株式会社 インダストリアル事業本部 精密機器技術センター)
参加費	法人会員：無料

	非会員： 一般 会場参加 3,000 円 / オンライン参加 3,000 円 (同額) 学生 会場参加 3,000 円 / オンライン参加 1,000 円 (オンライン参加者の参加費は、後日請求させていただきます)
申し込み方 法	参加には事前の登録が必要になりますので、非会員の方は本研究会のオンライン担当までお 問い合わせください。(info-ecpm@elecera.org)
HP	http://elecerapm.com/

本件に関するお問い合わせ先

日機装株式会社 インダストリアル事業本部 精密機器事業
精密機器東日本営業一部 国内営業グループ <kouatsu-tokyo@nikkiso.co.jp>
[TEL:03-3443-3753](tel:03-3443-3753)